

# ピクセル半導体検出器の開発



### 陣内 修

#### 東工大理学院

先端物理計測開発室キックオフワークショップ

2016. 12. 22

2016/12/22 AILAP workshop 陣内修

## LHC Run-1 (8TeV) 素粒子標準模型の成功

標準模型=「17の素粒子」+「場の理論」 ゲージカに基づく量子場の計算が 自然を完璧に表現











2016/12/22 AILAP workshop 陣内修

- BSMの2大根拠
  - 階層性問題(ヒッグス質量問題)
  - 暗黒物質候補



#### 超対称性粒子探索の例



#### ■ 新物理発見の鍵を握るのは

- レプトン(電子、ミューオン)
- ジェット(特にb–クォーク起源)
- 消失エネルギー

荷電粒子の飛跡検出 がとても重要







## LHC実験 高輝度化計画

2016/12/22 AILAP workshop 陣内修



- HL(高輝度)-LHCでは
  - エネルギーは据え置き
  - 瞬間luminosity:現設計の 5-7倍
  - 積算luminosity:2023年までの10倍
- データを増やすだけでOK?
  - 実効的にエネルギースケールの増加



# 大輝度化の代償→検出器への厳しい要求

- 現行の飛跡検出器は2023年まで(放射線損傷、読み出し)
- 半径1m内の飛跡検出器を一新する



- 受容放射線量:現行検出器の約10倍
  - 放射線耐性 5x10<sup>15</sup> [n<sub>eq</sub>/cm<sup>2</sup>]で動作
- pile-up ~200同時衝突
  - ピクセルの微細化 →50x50 µm<sup>2</sup>

この要求を満たすPIXEL検出器の開発 アトラス内規格 & 国際競争



n=200のシミュレーション

2016/12/22

陣内修

**AILAP workshop** 

ピクセル検出器

2016/12/22 **AILAP workshop** 随内修

3Dトラッキング



FEチップに

ピクセル状に細分化された検出器 どうやって信号を読み出すのか →センサー部は一体、 n-p接合 & 読み出し電極がピクセル状 →読み出しASIC(FEチップ)と直接接合



Pixelセンサーの性能

10

### ■ 評価基準

■ 安定した製作歩留まり・動作

### ■ 検出効率

- 入射した荷電粒子に対しヒット信号を出すか
- エネルギー損失は必須→電荷を正しく収集できるか
- センサー全体で99%以上が目安
- 電荷量測定
  - センサー→ASIC(デジタル化)→読み出し
  - 電荷量情報はTOTという数値化(4bit)

### 放射線損傷後にこれらを保障する必要

**Time over Threshold** 



Vthを越えた時間(25 ns単位)

11

### アトラス日本シリコングループとの共同研究で進めている



陽子線照射試験

- 東北大CYRICにて、70MeVの陽子線を用いた照射試験
  - 照射量目安: 3x10<sup>15</sup> [1MeVn<sub>eq</sub>/cm<sup>2</sup>]
    HL-LHC Pixel 3層目 10年間の放射線量の2倍
  - beam auto scan:満遍なく照射
  - 照射量は下流のドシメトリで測定





Irradiation box @ CYRIC

粒子ビーム試験

- 目的:
  - 開発中の検出器のピクセルサイズより 1/10程度の分解能で、検出効率 などの構造依存性を検証する

- 場所:主にCERN SPS
  - 120GeV 荷電π粒子
  - 高位置分解能(18x18µm<sup>2</sup>)の ピクセル検出器でトラッキング (σ=3~5µm)

荷雷π



13

2016/12/22

随内修

**AILAP workshop** 



14

# (2016年6月に行われたビーム試験の解析結果) ピクセル内のヒット位置ごとの検出効率



様々な試行錯誤の末(割愛)、

一様に高効率なセンサーの製造方法を確立
 →ピクセルの境界部で若干の検出効率低下があるが支障なし

2016/12/22 AILAP workshop 陣内修

- LHCでは飛跡検出器が重要な役割を担う
- HL-LHC用のピクセル検出器開発を進めている
- より最終版(実機)に近い型のセンサーで現在試験を 進めている。
  - 40 mm x 40 mm (ASIC 4つ搭載)
  - 50x50 μm<sup>2</sup> ピクセルサイズ
  - 専用高速読み出しASICへの対応
- 来年度末の「技術選択」で残ることが目標





